

RETTIFICHE

Retifica del regolamento (CE) n. 2116/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1480/2003 che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340 del 23 dicembre 2005)

A pagina 9, considerando 16:

anziché: «nelle situazioni in cui le DRAM in forme multicominate»,

leggi: «nelle situazioni in cui le forme multicominate (non customizzate) di DRAM».

A pagina 9, considerando 19:

anziché: «integrate in DRAM in forme multicominate»,

leggi: «integrate in forme multicominate (non customizzate) di DRAM».

A pagina 9, considerando 20:

anziché: «... dopo essere state integrate nelle DRAM in forme multicominate le DRAM in forma di chip o le DRAM montate non possono più essere considerate un prodotto potenzialmente assoggettato al dazio compensativo. A questo proposito, la Commissione ritiene che le DRAM in forma di chip e le DRAM montate mantengono le loro proprietà e funzioni anche dopo essere state integrate in DRAM in forme multicominate. Il fatto di essere integrate in DRAM in forme multicominate non altera le loro caratteristiche fisiche e tecniche di base. Inoltre, la funzione svolta dalle DRAM in forme multicominate, che consiste nel fornire memoria, corrisponde esattamente, anche se su scala maggiore, a quella delle singole DRAM in forma di chip e delle singole DRAM montate. La Commissione conclude pertanto che l'integrazione in DRAM in forme multicominate non altera la natura delle DRAM in forma di chip o delle DRAM montate ...»,

leggi: «... una volta integrate nelle DRAM in forme multicominate (non customizzate) le DRAM in forma di chip o le DRAM montate non possono più considerarsi un prodotto potenzialmente assoggettato al dazio compensativo. A questo proposito, la Commissione ritiene che le DRAM in forma di chip e le DRAM montate mantengono le loro proprietà e funzioni anche dopo essere state integrate in DRAM in forme multicominate (non customizzate). Il fatto di essere integrate in DRAM in forme multicominate (ma non customizzate) non altera le loro caratteristiche fisiche e tecniche di base. La funzione svolta dalle DRAM in forme multicominate (non customizzate), che consiste nel fornire memoria, corrisponde inoltre esattamente, anche se su scala maggiore, a quella delle singole DRAM in forma di chip e delle singole DRAM montate. La Commissione conclude pertanto che l'integrazione in DRAM in forme multicominate (non customizzate) non altera la natura delle DRAM in forma di chip o delle DRAM montate ...»

A pagina 10, considerando 28, lettera c):

anziché: «importazioni di DRAM in forme multicominate»,

leggi: «importazioni di forme multicominate (non customizzate) di DRAM».

A pagina 11, considerando 30:

a) *anziché:* «... 4) nel caso di DRAM in forme multicominate»,

leggi: «... 4) nel caso di forme multicominate (non customizzate) di DRAM»;

b) *anziché:* «al valore complessivo delle DRAM in forme multicominate»,

leggi: «al valore complessivo delle DRAM in forme multicominate (non customizzate)».

A pagina 11, ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della tabella che figura nel considerando 30, nonché alle pagine 13 e 14 ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della tabella che figura nell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1480/2003:

anziché: «DRAM in forme multicominate»,

leggi: «DRAM in forme multicominate (non customizzate)».